



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100716002
2010 年 7 月 27 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

PWR(パワーマネジメント) UCC2xxx製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての一次予定の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知受領後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知後 **30 日以内**にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知の **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 **24 ヶ月**以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	■Initial notice (Plan)	□Final notice
変更概要	Design/Specification	□Design □Electrical □Mechanical
	Wafer Fab	□Site □Process □Material
	Wafer Bump	□Site □Process □Material
	■Assembly	□Site □Process ■Material
	Test	□Site □Process
	Others	□Packing/Shipping/Labeling □ -
変更内容	PWR(パワーマネジメント) UCC2xxx 製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 ボンディングワイア 変更後 : Cu(銅)線 ボンディングワイア	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	11 月上旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	■計画	□終了
製品表示	■変更無し	□変更あり
備考	—	

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 PWR(パワーマネジメント) UCC2xxx製品について、現行 Au(金)線 ボンディングワイアを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び部材調達利便性向上の為に、これに替わり、Cu(銅)線 ボンディングワイアへ移行する予定です。対象製品について、TI-Mexico(メキシコ)組立サイト及びボンディングワイア以外の部材変更はない予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線
ボンディングワイア径	1.3 mils	1.3 mils

理由: 機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び部材調達利便性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
HPA00231D	UCC27201DR	UCC28600DRG4	UCC2892DR	UCC2894DG4
HPA00231DR	UCC27201DRG4	UCC2891D	UCC2892DRG4	UCC2894DR
HPA00932DR	UCC28089D	UCC2891DG4	UCC2893D	UCC2894DRG4
UCC27200DR	UCC28089DG4	UCC2891DR	UCC2893DG4	
UCC27200DRG4	UCC28089DR	UCC2891DRG4	UCC2893DR	
UCC27201D	UCC28089DRG4	UCC2892D	UCC2893DRG4	
UCC27201DG4	UCC28600DR	UCC2892DG4	UCC2894D	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 6 月	終了	2010 年 8 月
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Device ID:	Device1	Device2	Device3	
Qual Device:	TPS40200D	TPS54331D	UCC2894D	
Die Sizes (mm):	1.45 X 1.41	1.42 X 1.24	2.03 X 2.64	
Assembly Site:	FMX	FMX	FMX	
Package/Code/Pins:	SOIC/ D/8	SOIC/ D/8	SOIC/ D/16	
Mount Compound:	4147858	4147858	4147858	
Mold Compound:	4205694	4205694	4205694	
Bond Wire:	1.3 Mil Dia. Cu	1.3 Mil Dia. Cu	1.3 Mil Dia. Cu	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	JEDEC L-1/260C	JEDEC L-1/260C	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Device1	Device2	Device3
Electrical Characterization	-	30	30	30
**High Temp Storage Bake	170C, 420Hrs.	77	77	77
**Autoclave	121C, 96Hrs.	77	77	77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500cycles	77	77	77
**Temp Cycle	-55C/125C, 1000cycles	77	77	77
Destructive Physical Analysis	Post Temp Cycle	per spec	per spec	per spec
Manufacturability (Assembly)	per assembly site spec	per spec	per spec	per spec
**Thermal Shock	-65C/150C, 500Cyc	77	77	77
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-1 / 260C				